



A Meridian Adhesives Group Company

EPO-TEK®

# 选型指导手册

Specialty Epoxies,  
UV & UV Hybrids



光学胶

导热胶

导电胶

[www.epotek.com](http://www.epotek.com)

UV+热 双固型胶

# EPO-TEK® 光学胶

Epoxy Technology's 光学胶系列产品被广泛用于粘接、灌封和涂层等应用场景，常见的是光纤应用。我们的环氧树脂胶粘剂常用于包裹光纤和连接光器件元件。



## EPO-TEK® 光学胶产品列表

| EPO-TEK®  | 固化前/后颜色<br>(薄片) | 固化条件<br>(最低)                      | 粘度 @ 23°C(cPs)             | 玻化温度 (°C) | 剪切强度(PSI) | 膜量(PSI) | 折射率(Nd) | 光谱透射                                          | 可操作时间<br>(@ 室温) |
|-----------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 301       | 透明 / 无色         | 65°C - 1 hour<br>23°C - 24 hours  | @ 100 rpm<br>100 - 200     | ≥65       | >2,000    | 436,249 | 1.5190  | ≥99% @ 382 - 980nm<br>≥97% @ 980 - 1640nm     | 1-2 hours       |
| 301-2     | 透明 / 无色         | 80°C - 3 hours<br>23°C - 2 days   | @ 100 rpm<br>225 - 425     | ≥80       | >2,000    | 432,279 | 1.5318  | >99% @ 400 - 1200nm<br>>98% @ 1200 - 1600nm   | 8 hours         |
| 301-2FL   | 透明 / 无色         | 80°C - 3 hours<br>23°C - 3 days   | @ 100 rpm<br>100 - 200     | ≥45       | >2,000    | 318,685 | 1.5102  | >99% @ 400 - 1000nm<br>>97% @ 1000 - 1600nm   | 10 hours        |
| 302       | 透明 / 淡黄         | 23°C - 2 hours                    | @ 20 rpm<br>5,000 - 10,000 | ≥40       | 1,756     | 153,918 | 1.5442  | >85% @ 440 - 900nm<br>>88% @ 900 - 1600nm     | 10 min          |
| 302-3M    | 透明 / 无色         | 65°C - 3 hours<br>23°C - 24 hours | @ 100 rpm<br>800 - 1,600   | ≥55       | >2,000    | 456,443 | 1.5446  | >95% @ 460 - 1620nm                           | 1 hour          |
| 305       | 透明 / 无色         | 65°C - 1 hour<br>23°C - 24 hours  | @ 100 rpm<br>150 - 250     | ≥35       | 1,880     | 100,395 | 1.4763  | >95% @ 340nm<br>>98% @ 400-1600nm             | 1 hour          |
| 310M-2    | 透明 / 无色         | 65°C - 2 hours<br>23°C - 24 hours | @ 100 rpm<br>250 - 325     | ≤ 30      | 678       | 1,936   | 1.4947  | >98% @ 380 - 1660nm                           | 1.5 hours       |
| 320 †     | 黑色 / 黑色         | 65°C - 2 hours<br>23°C - 24 hours | @ 100 rpm<br>700 - 1,200   | ≥55       | >2,000    | 506,751 | N/A     | <1% @ 300 - 2500nm                            | 1 hour          |
| 323LP     | 淡黄 / 琥珀色        | 90°C - 30 min                     | @ 50 rpm<br>3,500-5,000    | ≥100      | >2,000    | 444,110 | 1.5704  | >90% @ 640 - 800nm<br>>94% @ 820 - 1620nm     | 24 hours        |
| 353ND     | 琥珀色 / 深红        | 150°C - 1 min<br>100°C - 10min    | @ 50 rpm<br>3,000 - 5,000  | ≥90       | >2,000    | 508,298 | 1.5694  | >98% @ 800 - 1000nm<br>>95% @ 1100 - 1600nm   | ≤3 hours        |
| 353ND-T†  | 棕褐色 / 深红        | 150°C - 1 min<br>100°C - 10min    | @ 20 rpm<br>9,000 - 15,000 | ≥90       | 1,953     | 559,120 | N/A     | N/A                                           | 3 hours         |
| 354       | 琥珀色 / 深红        | 150°C - 10 min<br>80°C - 2 hours  | @ 50 rpm<br>4,000 - 6,000  | ≥95       | 1,668     | 356,376 | 1.5734  | >96% @ 600nm<br>>99% @ 800nm                  | 3 days          |
| 360       | 淡黄 / 琥珀色        | 150°C - 1 min<br>100°C - 10 min   | @ 100 rpm<br>350 - 550     | ≥90       | >2,000    | 322,012 | 1.5345  | >97% @ 700 - 1600nm<br>>88% @ 600nm           | 6 hours         |
| 377       | 琥珀色 / 深琥珀色      | 150°C - 1 hour                    | @ 100 rpm<br>150 - 300     | ≥95       | 1,456     | 373,622 | 1.5195  | ≥90% @ 600nm - 1000nm<br>≥98% @ 1000 - 1600nm | 24 hours        |
| 383ND     | 琥珀色 / 深红        | 90°C - 30 min                     | @ 50 rpm<br>3,500 - 6,000  | ≥100      | >2,000    | 369,039 | 1.5715  | ≥90% @ 520 - 1600nm                           | 8 hours         |
| OD1001-67 | 奶油色 / 棕褐色       | 150°C - 30 min<br>125°C - 1 hour  | @ 100 rpm<br>1,400         | 3         | N/A       | 111,780 | 1.5247  | ≥90% @ 660 - 2100nm                           | 28 days         |
| OD2002    | 蜜蜡琥珀/深琥珀色       | 150°C - 5 min<br>100°C - 30 min   | @ 5 rpm<br>24,000 - 42,000 | ≥140      | 1,570     | 263,291 | 1.5728  | >98% @ 800 - 1640nm                           | 4 hours         |

Note: 23°C 表示室温固化 † 触变性膏状

## EPO-TEK® 301 胶粘剂系列

301系列胶粘剂的物理状态是无色透明的，此系列含有多种相关配方以满足您具体的应用需求。

|       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| 室温固化  | 301, 301-1, 301-2, 301-2FL, 302, 305, 310M-2 |
| 低粘度   | 301, 301-1, 301-2 & 301-2FL                  |
| 低应力   | 301-2FL, 302, 305, 310M-2                    |
| 长操作时间 | 301-2 (8 小时), 301-2FL (10 小时)                |

\* 固化温度越高则固化速度越快。查看产品信息表以获取其他固化方法。

## EPO-TEK® 353ND 胶粘剂系列

353ND系列胶粘剂是我们最受欢迎的胶粘剂产品系列之一。其多样性可以通过以下几个特性区分：

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| 长操作时间       | 323LP (24 小时), 354 (3 日) & 383ND (8 小时) |
| 高玻璃化温度      | OD2002 (强度高, 模量低)                       |
| 高触变值        | 323LP-T, 353ND-T, 354-T                 |
| UV 固定       | HYB-353ND (请参阅 UV 双固型胶)                 |
| UV 固定 & 触变性 | HYB-353ND-TX2, HYB-353ND-TX3            |

**EPOXY**  
TECHNOLOGY

A Meridian Adhesives Group Company



EPO-TEK产品提供预混型单组分针筒包装 (PMF)

**EPO-TEK® 预混单组分针筒装 (PMF) 优点:**

- ☑ 提高可靠性和稳定性，操作更简单
- ☑ 无需混合，降低环境损害提高生产力
- ☑ 成本效益



# EPO-TEK® 导热胶



EPO-TEK® 导热绝缘环氧胶被广泛应用于许多高科技电子产品以达到优越的性能及导热效果。产品固化后物理特性从刚硬（提供耐热增强型电路保护）至柔韧（适用于热膨胀系数不匹配的基材）可选择

## EPO-TEK® 导热绝缘胶水系列

| EPO-TEK®        | 固化条件(最低)                                                       | 粘度 @ 23°C(cPs)                | 玻化温度(°C) | 芯片剪切力 @室温<br>(80 mil X 80 mil) | 膜量<br>(PSI) | 导热系数<br>(W/m²K) | 建议间接性操作温度(°C) | 可操作时间<br>(@室温) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| 930-4           | 150°C - 10 min<br>80°C - 6 hours                               | @ 20 rpm<br>12,000 - 17,000   | ≥90      | ≥15kg / 5,334psi               | 607,651     | 1.70            | <325          | 1 day          |
| H65-175MP†      | 180°C - 1 hour                                                 | @ 2.5 rpm<br>80,000 - 120,000 | ≥100     | ≥20kg / 7,112psi               | 816,394     | 0.80            | <300          | 28 days        |
| H67-MP†         | 150°C - 1 hour                                                 | @ 1 rpm<br>300,000 - 400,000  | ≥90      | ≥20kg / 7,112psi               | 641,860     | 0.50            | <300          | 28 days        |
| H70E            | 150°C - 5 min<br>80°C - 90 min                                 | @ 50 rpm<br>4,000 - 7,000     | ≥80      | ≥10kg / 3,556psi               | 787,350     | 0.90            | <300          | 2 days         |
| H70E-2          | 150°C - 5 min<br>80°C - 90 min                                 | @ 20 rpm<br>9,000 - 15,000    | ≥80      | ≥5kg / 1,778psi                | 1,214,415   | 1.00            | <300          | 2 days         |
| H74             | 150°C - 5 min<br>100°C - 20 min                                | @ 5 rpm<br>45,000 - 65,000    | ≥100     | ≥15kg / 5,334psi               | 860,430     | 1.30            | <350          | 2 hours        |
| H77             | 150°C - 1 hour<br>100°C - 1 hour+<br>120°C - 2 hours<br>step } | @ 20 rpm<br>6,000 - 12,000    | ≥80      | ≥5kg / 1,778psi                | 950,693     | 0.70            | <350          | 6 hours        |
| T7109           | 150°C - 10 min<br>80°C - 8 hours                               | @ 20 rpm<br>14,000 - 20,000   | ≥45      | ≥15kg / 5,334psi               | 258,593     | 0.70            | <300          | 4 hours        |
| T7109-19        | 80°C - 2 hours<br>23°C - 2 days                                | @ 5 rpm<br>40,000 - 70,000    | ≤40      | ≥5kg / 1,778psi                | 29,931      | 1.30            | <250          | 2 hours        |
| T7110           | 80°C - 2 hours<br>23°C - 3 days                                | @ 100 rpm<br>1,400 - 2,200    | ≥40      | ≥10kg / 3,556psi               | 789,250     | 1.00            | <250          | 3.5 hours      |
| T905BN-3        | 80°C - 2 hours                                                 | @ 50 rpm<br>2,000 - 7,000     | ≥40      | ≥10kg / 3,556psi               | 721,520     | 2.00            | <300          | 3 hours        |
| TJ2139-LH BLACK | 200°C - 5 min<br>140°C - 40 min                                | @ 10 rpm<br>25,000-35,000     | ≥100     | ≥30 Kg / 10,668 psi            | 631,753     | 0.50            | <350          | 2.5 days       |
| TV2001          | 160°C - 5 min<br>120°C - 30 min                                | @ 20 rpm<br>10,000 - 20,000   | ≥15      | ≥15kg / 5,334psi               | 16,271      | 0.40            | <325          | 2 days         |
| TZ101           | 150°C - 1 hour                                                 | @ 10 rpm<br>24,000 - 30,000   | ≥40      | ≥10kg / 3,556psi               | 513,778     | 0.90            | <275          | 28 days        |

Note: 23° C denotes RT cure † MIL-STD 883/5011 certified

## 高导热产品

EPO-TEK® 产品的导热性能，介电强度及保护电路板抗严峻环境性能方面优异。

### 930-4\*

- 可操作时间长
- 低温固化
- 粘接力强，适用于多种材质
- 小填料粒径 ( $\leq 20\mu\text{m}$ )

### H74\*

- 触变性膏状
- NASA 低挥发性
- 优越的耐化学性及耐湿性
- 中等填料粒径 ( $\leq 50\mu\text{m}$ )

### H70E\*

- 操作时间长
- 半导体芯片粘接
- 精度点胶
- NASA低挥发性

## 低应力/柔韧/兼容产品

这个系列的特殊配方主要针对低应力需求的应用。例如：大面积粘接，灌封和冷热循环。

### T7109

- 针筒点胶
- 耐热循环
- 光学封装

### TZ101\*

- 低玻璃化温度&低模量
- 可操作时间长
- 高强度
- 单组分

### TV2001

- 低玻璃化温度
- 低模量
- 强度高
- 粘结力强

## 低温固化产品

### T7109-19\*

- 低玻璃化温度
- 低模量
- 高导热系数
- 可室温固化

### T7110\*

- 低粘度，自流平
- 室温固化
- 可大规模灌胶

### T905BN-3

- 适用于大体积应用
- 灌封 & 铸造
- 大粒径 ( $< 300\mu\text{m}$ )
- 防干扰的

*\* Variations of these formulations available*

**EPOXY**  
TECHNOLOGY

A Meridian Adhesives Group Company



EPO-TEK产品提供预混型单组分针筒包装 (PMF)

EPO-TEK预混单组分针筒装 (PMF)优点:

- ✓ 提高可靠性和稳定性操作更简单
- ✓ 无需混合，降低环境损害提高生产力
- ✓ 提升产能 - 性价比高

# EPO-TEK® 导电胶

Epoxy Technology 提供各种导电导热环氧树脂胶粘剂 (ECA)。我们丰富的产品线可供用户能根据不同的应用，结合胶粘剂的物理、导电性、机械特点等性能，轻松地挑选出较好的胶粘剂以满足特殊的应用需求。



## EPO-TEK® 导电胶产品列表

| EPO-TEK®          | 固化条件(最低)                                                   | 粘度 @23°C<br>(cPs)           | 玻化温度 (°C) | 芯片剪切力 @ 室温<br>(80 mil X 80 mil) | 体积电阻率<br>(ohm-cm) | 导热系数<br>(W/m²K)         | 建议间接性<br>操作温度(°C) | 膜量<br>(PSI) | 可操作时间<br>(@室温) |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|----------------|
| <b>E2101</b>      | 150°C - 1 hour                                             | @ 20 rpm<br>15,000 - 18,000 | ≥90       | >5kg / 1,778psi                 | ≤0.0005           | 2.50                    | <300              | 1,052,430   | 5 days         |
| <b>EJ2108</b>     | 150°C - 1 hour<br>80°C - 2 hour<br>23°C - 3 days           | @ 10 rpm<br>8,000 - 20,000  | ≥30       | ≥ 5kg / 1,778psi                | ≤0.0001           | 4.00                    | <175              | 2,553       | 1 hour         |
| <b>EJ2189-LV</b>  | 150°C - 1 hour<br>23°C - 3 days                            | @ 1 rpm<br>25,000 - 45,000  | ≥40       | ≥10kg / 3,556psi                | ≤0.0005           | 2.50                    | <250              | 213,672     | 4 hours        |
| <b>EJ2312</b>     | 150°C - 1 hour<br>23°C - 24 hours                          | @ 1 rpm<br>58,822           | N/A       | ≥13kg / 4,623psi                | ≤0.0005           | 5.6                     | <250              | N/A         | 90 mins        |
| <b>EK1000†</b>    | 150°C - 1 hour<br>Step: 150°C - 1 hour +<br>200°C - 1 hour | @ 100 rpm<br>1,800 - 3,600  | ≥80       | >10kg / 3,556psi                | ≤0.00009          | 26.3<br>(two-step cure) | <300              | 273,528     | 2 weeks        |
| <b>H20E†</b>      | 150°C - 5 min<br>80°C - 3 hours                            | @ 100 rpm<br>2,200 - 3,200  | ≥80       | >10kg / 3,556psi                | ≤0.0004           | 2.50                    | <300              | 808,700     | 2.5 days       |
| <b>H20E-PFC</b>   | 175°C - 45 sec<br>80°C - 3 hours                           | @ 100 rpm<br>3,000 - 4,000  | ≥80       | ≥5kg / 1,778psi                 | ≤0.0004           | 3.20                    | <325              | 921,254     | 3 days         |
| <b>H20S</b>       | 150°C - 5 min<br>80°C - 90min                              | @ 100 rpm<br>1,800 - 2,800  | ≥80       | ≥5kg / 1,778psi                 | <0.0005           | 3.3                     | <300              | 339,720     | 3 days         |
| <b>H22</b>        | 150°C - 5 min<br>100°C - 20min                             | @10 rpm<br>17,000 - 30,000  | ≥100      | ≥5kg / 1,778psi                 | ≤0.005            | 0.90                    | <350              | 540,120     | 16 hours       |
| <b>H35-175MP*</b> | 180°C - 1 hour<br>165°C - 1.5 hours                        | @ 10 rpm<br>22,000 - 28,000 | ≥100      | ≥10kg / 3,556psi                | ≤0.0005           | 1.50                    | <300              | 1,106,623   | 28 days        |
| <b>H37-MP*</b>    | 150°C - 1 hour                                             | @ 10 rpm<br>22,000 - 26,000 | ≥90       | ≥10kg / 3,556psi                | ≤0.0005           | 1.59                    | <300              | 727,680     | 28 days        |

\* Certified to MIL-STD 883/5011 (MP) † H20E and EK1000 are also available in "MP" grade

## 室温固化系列

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| EJ2189    | 稳定 & 优异附着力的可室温固化胶粘剂    |
| EJ2189-LV | EJ2189的低粘度版（和H20E粘度近似） |
| EJ2108    | 具有一定的活性的室温固化           |
| EJ2312    | 超快速固化的导电胶              |

## 高导热系数/低体积电阻

新一代创新导电胶，优异的性能及导热性能

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| EK2000     | 双组分导热优异的导电胶粘剂             |
| EK1000     | 导电导热性优异的单组分胶粘剂            |
| EK1000-1   | EK1000 工作时间加长版(<7天vs ≤1天) |
| EK1000-1-D | EK1000-1 可点胶性加强版          |

## 低应力/柔韧

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| EJ2108   | 中等粘度，具有低模量及可低温（80℃）固化的触变性胶粘剂 |
| EV2118-2 | 中等粘度，具有优异的导热性触变性胶粘剂          |

## 符合“行业标准”的导电胶产品

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| H20E                     | 长达50余年的可靠性证实         |
| H20E-FC                  | 快速固化版                |
| H20E-HC                  | 高导热率版                |
| H20E-PFC                 | 在丝网印刷/模板印刷工艺具有较好流变性  |
| H20S                     | 均匀的粘稠度，专为模型压印及点胶工艺设计 |
| H20E-D/H20S-D/H20E-PFC-D | 单组分，更适用于点胶工艺         |



A Meridian Adhesives Group Company



**EK1000-MP**

高导热率

**H20E-MP**

工业标准

**H35-175MP**

微型芯片& SMD键合

**H35-175MPLV**

粘度版本

**H35-175MPT**

高触变版本

**H37-MP**

H35-175MP的低应力和低固化温度版本

**H37MP-2**

略高粘度版本

**H37-MPT**

高触变版本

# EPO-TEK® UV 胶

Epoxy Technology提供了一个以环氧树脂及丙烯酸酯体系为基础的高性能UV固化胶粘剂。我们独特的UV配方提供了快速固化从而满足了广泛的应用需求。我们大部分的环氧胶/UV配方新产品都可以通过后热固化处理加强性能。



## EPO-TEK® UV 胶产品列表

### 环氧基 后热固化 - 提升固化程度，增强性能

#### UV + 后热固化 (一般为 80-150°C) 以提升产品性能

| EPO-TEK®  | 固化条件(最低)                                 | 粘度@ 23°C(cPs)                  | 玻化温度 (°C) | 硬度  | 折射率Nd* | 光谱透射                                       | 产品特性                          |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----|--------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| OG116     | 100mW/cm2 @ 240 – 365nm<br>for > 30 sec  | @ 2.5 rpm<br>80,000 – 105,000  | ≥135      | 80D | 1.5892 | 89% @ 400nm<br>≥98% @ 560 – 1660nm         | OG116-31的高粘度版，抗化学性强，高玻化温度和透光度 |
| OG116-31  | 100mW/cm2 @ 240 – 365nm<br>for > 30 sec  | @ 10 rpm<br>20,000 – 30,000    | ≥115      | 83D | 1.5842 | ≥92% @ 500nm<br>≥96% @ 660 – 1640nm        | 抗化学性强，高玻化温度和透光度，符合ISO 10993标准 |
| OG142-87  | 100mW/cm2 @ 240 – 365nm<br>for > 30 sec  | @ 100 rpm<br>250 – 600         | ≥100      | 82D | 1.5058 | >97% @ 580 – 1660nm                        | 低粘度，很强的粘接牢度，耐湿性佳              |
| OG142-95  | 100 mW/cm2 @ 240 – 365nm<br>for > 30 sec | @ 100 rpm<br>300 – 700         | ≥100      | 82D | 1.5123 | ≥ 97% @ 580 – 1660nm                       | OG142-87的湿润进阶版                |
| OG142-112 | 100mW/cm2 @ 240 – 365nm<br>for > 30 sec  | @ 100 rpm<br>1,200 – 1,700     | ≥90       | 83D | 1.5560 | >97% @ 500 – 1660nm                        | 中等粘度，耐湿性佳，很强的粘接牢度             |
| OG159-2   | 100mW/cm2 @ 240 – 365nm<br>for > 30 sec  | @ 2.5 rpm<br>100,000 – 140,000 | ≥30       | 69D | 1.5715 | ≥98% @ 580 – 2000nm                        | 具有触变性，含有25.4um直径的玻璃珠，很强的耐湿性   |
| UJ1190    | 100mW/cm2 @ 240 – 365nm<br>for > 60 sec  | @ 100 rpm<br>501               | 100       | 80D | 1.4993 | ≥80% @ 380 – 2440nm<br>≥94% @ 520 – 1560nm | 低粘度,适用于不同胶层厚度的应用              |
| UD1355    | 100mW/cm2 @ 240 – 365nm<br>for > 90 sec  | @ 100 rpm<br>447               | 36        | 77D | 1.4925 | ≥96% @ 800 – 2200nm<br>≥99% @ 360 – 780nm  | 光学透明，低粘度，过回流焊后不变色             |

\* Cured index measured at 589nm

#### UV + 后热固化 (一般 80-150°C) 适合阴影部分固化< 5mm shadow cure with proper thermal cure

| EPO-TEK®   | 固化条件(最低)                                | 粘度@ 23°C(cPs)              | 玻化温度 (°C) | 硬度  | 折射率Nd* | 光谱透射                | 产品特性             |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|-----|--------|---------------------|------------------|
| † OG198-54 | 100mW/cm2 @ 240 – 365nm<br>for > 30 sec | @ 100 rpm<br>200 – 450     | 131       | 86D | 1.5256 | ≥97% @ 460 – 1680nm | 低粘度，高玻化温度，很强粘接牢度 |
| † OG198-55 | 100mW/cm2 @ 240 – 365nm<br>for > 30 sec | @ 100 rpm<br>1,200 – 2,000 | ≥120      | 85D | 1.5196 | ≥97% @ 560 – 1680nm | 具有触变性，高粘度，高玻化温度  |

\* Cured index measured at 589nm † 150°C/1 hour to cure shadowed areas optional



## 环氧基 (继续)

| 仅 UV 固化                                  |                                         |                            |           |     |         |                                           |                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|-----|---------|-------------------------------------------|-------------------------|
| EPO-TEK®                                 | 固化条件(最低)                                | 粘度@ 23°C(cPs)              | 玻化温度 (°C) | 硬度  | 折射率Nd*  | 光谱透射                                      | 产品特性                    |
| OG133-7                                  | 100mW/cm2 @ 240-365nm<br>for > 2 min    | @ 100 rpm<br>150 - 450     | ≤10       | 81A | 1.5060† | ≥90% @ 440 - 580nm<br>≥96% @ 800 - 1600nm | 低粘度, 柔韧性, OG133-8的高流动版本 |
| OG133-8                                  | 100mW/cm2 @ 240-365nm<br>for > 90 secs  | @ 100 rpm<br>1,000 - 1,500 | ≤10       | 65A | 1.5244  | ≥90% @ 580 - 800nm<br>≥95% @ 820 - 1660nm | 具有触变性, 低玻璃化温度和硬度, 柔韧性   |
| OG142                                    | 100mW/cm2 @ 240 - 365nm<br>for > 30 sec | @ 20 rpm<br>9,000 - 15,000 | ≥95       | 86D | 1.5809  | ≥92% @ 440 - 620nm<br>≥97% @ 660 - 1640nm | 中等粘度, 强度高及耐湿性           |
| OG154-1                                  | 100mW/cm2 @ 240 - 365nm<br>for > 30 sec | @ 5 rpm<br>26,000 - 34,000 | 128       | 80D | 1.5692  | 97% @ 500 - 1660nm                        | 高粘度, 高玻璃化温度和低模量         |
| * Cured index measured at 589nm    † 未固化 |                                         |                            |           |     |         |                                           |                         |

## 丙烯酸基

| 仅 UV 固化                                  |                                        |                            |           |     |         |                                     |                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----------|-----|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| EPO-TEK®                                 | 固化条件(最低)                               | 粘度@ 23°C(cPs)              | 玻化温度 (°C) | 硬度  | 折射率Nd*  | 光谱透射                                | 产品特性                                 |
| OG603                                    | 100mW/cm2 @ 240 - 365nm<br>for > 5 sec | @ 100 rpm<br>150 - 250     | ≥70       | 84D | 1.5037  | ≥98% @ 420 - 1600nm                 | 低粘度, 快速固化                            |
| OG653                                    | 100mW/cm2 @ 240 - 365nm<br>for > 1 sec | @ 100 rpm<br>650 - 850     | 65        | 76D | 1.5106  | ≥83% @ 380nm<br>≥97% @ 440 - 2220nm | 低粘度, 绿色, 具有光隔离性能<br>快速固化(1-3秒@365nm) |
| OG675                                    | 100mW/cm2 @ 240 - 365nm<br>for > 2 sec | @ 100 rpm<br>2,000 - 5,000 | ≥-5       | 70A | 1.4790† | ≥98% @ 400 - 1660nm                 | 中等粘度, 快速固化, 低玻璃化温度                   |
| * Cured index measured at 589nm    † 未固化 |                                        |                            |           |     |         |                                     |                                      |



EPO-TEK产品提供预混型单组分针筒包装 (PMF)

**EPO-TEK®预混单组分针筒装 (PMF)优点:**

- ☑ 提高可靠性和稳定性操作更简单
- ☑ 无需混合, 降低环境损害提高生产力
- ☑ 提升产能 - 性价比高

**EPOXY**  
TECHNOLOGY  
A Meridian Adhesives Group Company

# EPO-TEK®紫外+热 双固型胶

Epoxy Technology 开发了全新的产品线，主要以环氧树脂为化学基础的UV混合系统胶粘剂（UV Hybrid Adhesives）。这个全新的产品配方技术可以通过利用UV及加热固化的掌控，有效的改良工艺上的操作流程。可以在短短几秒钟以内完成预固化，接着再加热固化；从而在工艺上达到了速度与强度的结合。

## EPO-TEK® UV +热 双固型胶粘剂产品系列

| EPO-TEK®      | 描述                       | 粘度                          | 可操作时间   | 玻化温度(°C) | 固化条件                                   | 降解温度 (°C) | 失重率 @ 200°C | 芯片剪切力            | 光谱透射                                      | 折射率    |
|---------------|--------------------------|-----------------------------|---------|----------|----------------------------------------|-----------|-------------|------------------|-------------------------------------------|--------|
| HYB-353ND-LV  | 低粘度, fast tack           | 800 - 2,000 cPs @100 rpm    | <20 hrs | ≥80      | UV 10 sec @ 100mW/cm2 +150°C/30min     | 400       | 0.08%       | ≥15kg / 5,334psi | ≥95% @ 1100 -1600nm<br>≥98% @ 800 -1000nm | 1.5215 |
| HYB-353ND     | Viscosity match of 353ND | 3,000 - 7,000 cPs @10 rpm   | <2 hrs  | ≥100     | UV 20 sec @ 100mW/cm2 @ + 150°C/30 min | 400       | 0.06%       | ≥20kg / 7,112psi | ≥95% @ 1100 -1600nm<br>≥98% @ 800 -1000nm | 1.5259 |
| HYB-353ND-HV  | Higher viscosity version | 9,000 - 20,000 cPs @10 rpm  | 2 hrs   | ≥100     | UV 10 sec @ 100mW/cm2 @ + 150°C/30 min | 388       | 0.03%       | ≥25kg / 8,890psi | ≥95% @ 1100 -1600nm<br>≥98% @ 800 -1000nm | 1.5545 |
| HYB-353ND-TX2 | Thixo version TI = 1.7T  | 17,000 - 35,000 cPs @10 rpm | <2 days | ≥90      | UV 10 sec @ 100mW/cm2 +150°C/30min     | 410       | 0.05%       | ≥15kg / 5,334psi | ≥95% @ 1100 -1600nm<br>≥98% @ 800 -1000nm | N/A†   |
| HYB-353ND-TX3 | 触变性 TI = 1.3             | 25,000 - 41,000 cPs @10 rpm | <3 days | ≥80      | UV 10 sec @ 100mW/cm2 +150°C/30min     | 399       | 0.19%       | ≥15kg / 5,334psi | ≥95% @ 1100 -1600nm<br>≥98% @ 800 -1000nm | N/A†   |

\* 未固化,在波长 589nm 下测试 † 未测试 可固化于更低的温度, (≥80°C) 取决于产品应用

## 紫外+热 双固型胶粘剂的优点

- ☑ 提高整体产线工艺流程
- ☑ 更易处理
- ☑ 增加昂贵的耦合设备上的产量
- ☑ 更低的应力和收缩率
- ☑ 几秒钟内完成表干预固化
- ☑ 85°C/85 RH性能可媲美353ND



## 什么是紫外+热 双固型胶粘剂？

环氧树脂/UV混合系统胶是一种新型材料，结合了环氧树脂的坚固性和UV胶的快速固化性能。这些胶粘剂能够在几秒钟内完成UV预固化方便了校准，耦合，流体控制与操作工艺，紧接着再进行热固化。这类产品对精密光学设备耦合应用无疑是很好的选择。

**EPOXY**  
TECHNOLOGY

A Meridian Adhesives Group Company

Packaging for EPO-TEK® UV Hybrid products is a single component syringe.

www.ttc-sh.com

EPO-TEK®'S SPECIALTY ADHESIVE PRODUCTS  
+ ADVANCED PACKAGING TECHNIQUES =

# PREMIUM ADHESIVE PERFORMANCE

Epoxy Technology, A Meridian Adhesives Group Company, is a global leader in formulating, manufacturing and packaging specialty adhesives. We have packaging facilities in North America, Europe and Asia.

Our specialty formulated adhesives are packaged with meticulous attention to specifications in the following packaging options:

Premixed and  
Frozen (PMF)  
Syringes



Room  
Temperature  
Stabilized  
Syringes  
(UV Products Only)



Bi-Paks



## Why Use EPO-TEK® Packaged Adhesives?

### Increased Reliability/Consistency/Uniformity

- ✓ Precise Mix Ratio, Lot to Lot

### Cost Effective

- ✓ Time Saving in Preparation of Material, Increased Productivity

### Ease of Use

- ✓ Convenient, No Measuring, No Mixing, Ready to Use, Stress Free

**EPOXY**  
TECHNOLOGY

A Meridian Adhesives Group Company



A Meridian Adhesives Group Company

Established in 1966, Epoxy Technology is a global leader of adhesives including Specialty Optical, Thermally Conductive (TCA), Electrically Conductive (ECA) and UV/UV Hybrids. Additionally, we offer an extensive line of tested and certified biocompatible/medical device grade adhesives, known as our "MED" LINE.

*In 2018, ETI became part of the Meridian Adhesives Group, a full-service global adhesive solutions provider. As part of Meridian's Electronics Division, Epoxy Technology works closely with Epoxy Technology Europe, Epoxies, Etc., and Pacific Adhesives Systems. Together, the Electronics Division offers high-impact products to a wide range of markets globally, such as Optoelectronics, Medical Electronics, Consumer Electronics, and Automotive Electronics, including the rapidly emerging Electric Vehicle sector. Our high-performance materials are used in some of the most demanding and increasingly difficult applications. We are trusted partners of organizations throughout the world.*

Epoxy Technology is an  
**ISO 9001: 2015**  
Certified Company



# Meridian Electronics



上海通泰化学有限公司

地址：徐汇区钦州北路1089号54栋2层B室

电话：021-60904313\*824

传真：021-64951096

Email: [service@tsishanghai.com](mailto:service@tsishanghai.com)

萨摩亚商昌顺科技有限公司台湾分公司

地址：新北市新庄区思源路175号九楼

电话：02-22506570

传真：02-22506211

Email: [service61@charmsontech.com.tw](mailto:service61@charmsontech.com.tw)

更多信息请上官网查询: [www.ttc-sh.com](http://www.ttc-sh.com)